

FPC-30 型带螺纹接口压力芯体

特 点

- 隔离膜片结构
- 高性能，全固态，高可靠性
- 全焊接结构
- 18 个月质保期

概 述

FPC-30 型带螺纹接口压力芯体将扩散硅压力芯片封装在带有螺纹接口的不锈钢底座上，芯体采用全焊接密封，无密封圈，可靠性能更高。



技术性能

量 程	10MPa…100MPa
电桥电阻	3K Ω ~6K Ω
供电电源	恒流 1.5mA、恒压 10V
使用温度	-45℃~125℃
补偿范围	-10℃~70℃
壳体和膜片	不锈钢 316L
精 度	0.25%FS（典型）
零 点	$\pm 2\text{mV}$
满量程	$\geq 100\text{mV}$ （1.5mA 供电）
零点温漂	0.02%FS/℃
灵敏度温漂	0.02%FS/℃
绝 缘	100M Ω /250VDC
长时间稳定性	0.2%FS/年
充 油	硅油
响应时间	$\leq 1\text{ms}$ （上升到 90%FS）
振 动	20g/（20~5000Hz）
耐用性周期	100 $\times$ 10 ⁶ FS

外形结构

